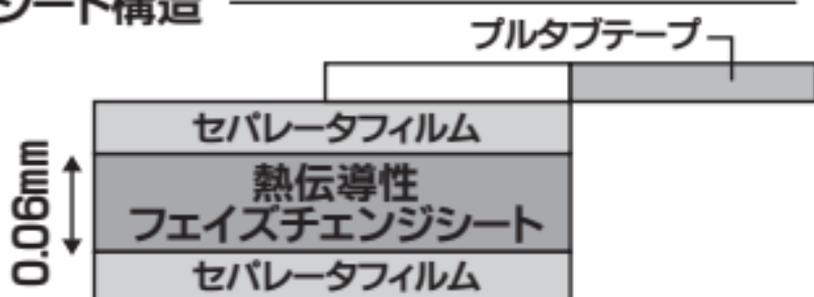


# HT-08 取扱説明書

- CPU やチップとヒートシンクの間に入れて使います。
- 熱により溶融し、薄膜化するので非常に優れた熱伝導率を実現します。
- 熱転写性が高く、取り扱い作業性に優れています。
- 加熱、加圧することにより、さらなる薄膜化が可能のため、非常に低い熱抵抗値を示します。
- 長期間使用しても安定した熱特性を示します。

## シート構造



## 転写方法



1 シート裏面のフィルムを剥がし、ヒートシンクにシートを貼り付けます。



2 上からシートをヒートシンクにしっかりと押し付けます。



3 さらに、手のひらで3～5分程度温めヒートシンクになじませます。



4 プラスチック製へら(GH-01)などで、左上部分を十分に擦り付けます。



5 ShinEtsuロゴの印刷されたタブフィルムを斜め45度方向に一気に剥します。

## 6 完成!!

ヒートシンクをチップの上に乗せれば完成です。

## クーラー/ヒートシンクの取り外し方法と除去方法

- PC使用直後の温まった状態であれば、剥がしやすいです。無理に剥がすと傷つける可能性があります。引っ張らず、左右にひねるようにして少しずつ剥がしていくと負荷が少ないです。
- 接触面積の多いチップは剥がれにくいことがあります。CPUがソケットから外れてピンを曲げてしまうことがありますのでご注意ください。
- 完全に除去する場合は弊社AS-CLNをご使用ください。

## ⚠ 注意

- ※ 接着力はありませんので、ヒートシンクをピンやネジで固定する環境でご使用ください。
- ※ 本製品の取り付けは使用者の責任において行ってください。
- ※ グリスなど、他の熱伝導材と併せて使用することはできません。